证券代码：300223　　证券简称：北京君正　　公告编号：2020-063

北京君正集成电路股份有限公司

2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北京君正	股票代码	300223
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张敏	白洁	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼 A 座一至三层	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼 A 座一至三层	
电话	010-56345005	010-56345005	
电子信箱	investors@ingenic.com	investors@ingenic.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	354,736,452.01	143,979,612.92	146.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,471,211.66	36,961,780.94	-68.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-11,127,636.21	12,395,985.36	-189.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,558,823.82	21,898,962.96	-79.18%

基本每股收益（元/股）	0.0568	0.1839	-69.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0568	0.1835	-69.05%
加权平均净资产收益率	0.92%	3.17%	-2.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,076,016,580.93	1,309,468,574.98	593.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,841,955,562.88	1,235,363,809.31	453.84%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数		39,052	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.43%	60,556,704	60,556,704		
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.43%	60,544,310	60,544,310		
上海双创投资管理有限公司－上海集岑企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.94%	53,835,926	53,835,926		
刘强	境内自然人	8.98%	40,475,544	30,356,658	质押	2,181,163
李杰	境内自然人	5.71%	25,728,023	22,173,141	质押	9,320,000
北京华创芯原科技有限公司	境内非国有法人	5.11%	23,054,968	23,054,968		
上海瑾矽集成电路合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.28%	14,795,533	14,795,533		
青岛民和志威投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.79%	12,577,174	12,577,174		
上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.69%	12,133,570	12,133,570		
冼永辉	境内自然人	2.42%	10,908,659	8,181,494		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东刘强和李杰先生为一致行动人，部分股东存在如下关联： 第一组关系：武岳峰集电（上海承裕）、屹唐投资、华创芯原： 1.1、关联方股权出资：北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）（以下简称“战新基金”）为屹唐投资的有限合伙人及关联方：战新基金作为有限合伙人，持有华创芯原单一股东北京集成 17.84%的财产份额；战新基金作为有限合伙人，持有武岳峰集电有限合伙人武岳峰浦江 18.20%的财产份额； 1.2、关联方担保及反担保：为私有化收购目的，屹唐投资、上海承裕、华创芯原、华清闪胜与中国工商银行股份有限公司作为牵头行牵头组织的银团于 2015 年 11 月签订《美国 ISSI 半导体公司并购项目银团贷款协议》，由银团向屹唐投资、上海承裕、华创芯原及华清闪胜提供私有化收购的并购贷款；由屹唐投资的关联方亦庄国投为上述贷款			

	提供担保。2015 年 11 月 19 日，华创芯原、华清闪胜、上海承裕与亦庄国投签署《股权质押反担保合同》，华创芯原、华清闪胜、上海承裕分别将其所持北京矽成相应股权质押予亦庄国投以提供反担保。 截至目前，华清闪胜、上海承裕均已还清并购贷款，所持北京矽成股权的质押登记已解除；华创芯原仍存在贷款余额，所持北京矽成股份质押已解除，所持北京君正部分股份仍质押予亦庄国投。 第二组关系：屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原、民和志威和闪胜创芯： 共同投资/出资：屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原、民和志威作为闪胜创芯有限合伙人，分别持有闪胜创芯 37.337%、22.806%、18.204%、15.104%、0.850%财产份额；第三组关系：武岳峰集电和上海集岑：间接出资关系：武岳峰集电作为有限合伙人的上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海承芯”，武岳峰集电持有其 99.999%财产份额）持有思源电气股份有限公司（以下简称“思源电气”）4.999995%股份（根据思源电气 2020 年 5 月 7 日公告)。 除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东上海双创金磐企业管理合伙企业（有限合伙）通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,057,335 股，实际合计持有 3,057,335 股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司完成了对北京矽成的资产交割，北京矽成作为公司全资子公司，自2020年6月起纳入公司合并报表编制范围。本次并购完成后，公司的业务体量、市场领域与资产规模均大幅提高，大大增强了公司的核心竞争力和抗风险能力。公司将充分发挥北京矽成境内外的资源与渠道及公司在国内的本地化优势，推动公司总体业务在全球范围内的协同发展。

由于新冠疫情先后在全球范围内爆发，公司境内外市场销售情况均受到较大影响。在此情况下，公司积极组织复工复产，加大产品的市场推广力度，挖掘重点市场潜力，不断寻找新的市场机会，努力降低疫情对公司经营的影响。同时，公司因收购产生存货、固定资产和无形资产等资产的评估增值，2020年6月当月新增资产摊销部分致使营业成本和经营费用同比大幅增长，从而使公司净利润大幅下降。报告期内，公司实现营业收入35,473.65万元，同比增长146.38%；实现净利润1,144.04万元，同比下降69.05%，其中归属于母公司股东的净利润1,147.12万元，同比下降68.96%。

1、技术与产品

公司拥有存储芯片、模拟与互联芯片、微处理器芯片和智能视频芯片等多个业务产品线。报告期内，根据市场需求和公司业务规划，公司积极推进各产品线的新产品开发，同时，持续加大研发投入，加强基础技术的研发和技术创新能力。

公司存储芯片分为SRAM、DRAM和Flash三大类别。公司SRAM产品品类丰富，从传统的Synch SRAM、Asynch SRAM

产品到行业前沿的高速QDR SRAM产品均拥有自主研发的知识产权；报告期内，公司进行了SPI/QPI/Hyper/Octal SRAM产品的工程验证及送样。公司DRAM产品开发主要针对具有较高技术壁垒的专业级应用领域，生产涵盖16M、64M、128M、256M、512M到1G、2G、4G、8G、16G等多种容量，不同界面、不同功耗规格的产品，能够满足工业、医疗，主干通讯和车规等级产品的要求，具备在极端环境下稳定工作、节能降耗等特点；报告期内，公司进行了不同高容量LPDDR4，LPDDR2，LPDDR等产品的研发、工程验证及送样，包括4G/8G DDR4，4G/8G LPDDR4等诸多产品。公司Flash产品线包括了目前全球主流的NOR FLASH存储芯片和NAND FLASH存储芯片，其中NOR FLASH存储芯片具有串口型和并口型两种设计结构，以及从256K至1G的多种容量规格，NAND FLASH存储芯片主攻1G-4G大容量规格，报告期内，公司继续进行面向汽车领域的512M/1G高容量及最新界面OCTAL Flash产品 研发和送样，并同时进行了新制程4G NAND Flash的产品开发。

公司模拟与互联产品线包括功放驱动DC/DC芯片、LED驱动芯片、触控传感芯片、车用微处理器芯片、光纤通讯驱动、LIN、CAN，G.hn等网络传输芯片，主要面向汽车、工业、医疗及高端消费类市场。报告期内，公司继续开发汽车应用的LIN、CAN，G.vn接口的网络传输产品、应用于汽车和高端消费类市场的灯效FxLED驱动芯片、汽车各种LED车灯驱动芯片、汽车DC/DC调节芯片、触摸传感器、10Gb光驱动芯片等，其中部分产品已获得客户验证，正在逐步进行量产。车用微处理器新产品也在进行最后功能验证以及客户送样中。

公司微处理器芯片新产品进行了功能验证和量产投片工作，预计可于2020年下半年完成量产工作。该芯片采用了公司最新的XBurst2 CPU核，主要面向物联网领域的中高端应用。

在智能视频领域，公司展开了下一代产品的研发，并预计于2020年下半年完成芯片设计并进行样品的投片。该芯片可满足智能视频领域不断提高的对AI处理能力的需求，并具有良好的性价比优势。

报告期内，公司持续进行核心技术的研发。根据市场对新产品的需求情况，公司进行了XBurst2 CPU的优化工作，并继续推进RISC-V CPU的研发，在视频编解码、影像信号处理、神经网络处理器、AI算法等领域继续推进相关技术的研发与创新，提高技术领先性，增强核心技术的积累；根据市场需求趋势，公司在存储业务方面不断积累高容量、高性能和低功耗方面的技术开发能力；在模拟与互联业务方面，公司在高亮度、高电流和灯效LED方面，以及先进的汽车内部连接技术方面持续进行研发投入，引领行业的需求趋势。

2、市场与销售

公司的存储芯片产品主要面向汽车、工业与医疗、通讯和消费等市场，报告期内，由于新冠疫情先后在国内和全球爆发，公司在汽车领域的市场推广受到较大影响，客户订单延期或取消情况导致公司在汽车市场的销售同比出现下滑。随着国内疫情的好转，国内汽车电子市场的需求于二季度开始逐渐恢复，国外不同国家和地区自二季度末也在不同程度地缓慢复工中；因医疗设备需求增长，公司存储芯片在医疗及其他相关工业设备领域同比增长较好；同时，公司在硬盘领域的销售使公司在消费市场保持了良好的销售趋势。

公司模拟与互联芯片可用于汽车、消费和工业等领域，报告期内，公司模拟芯片在游戏设备、白色家电、智能音箱等市场呈现出较好的增长趋势，从而带动公司该类芯片产品的总体增长。在汽车领域，公司逐渐将LED驱动芯片、传感芯片、LIN、CAN网络传输芯片等导入汽车供应链，推动客户的测试、验证和小批量生产，公司部分LED驱动芯片在汽车领域逐渐落地；公司连接类芯片在汽车领域的应用尚处于较早期的送样阶段。

报告期内，生物识别市场和教育电子市场的应用受疫情影响较大，一季度客户停工、减产情况较为严重，尽管二季度逐渐复工，仍对总体市场销售产生较大影响。在智能穿戴市场，由于应用种类的多样化，公司面向特定应用的市场需求减少，在这一市场，公司仍专注于将特定应用的方案做到极致，并不断寻求新的市场机会；二维码等条码市场的应用尽管也受到疫情一定程度的影响，但公司在该市场具有很好的产品优势和品牌优势，同时市场总体仍处于良好的增长趋势中，疫情期间公司积极配合客户的产品开发工作，充分保障客户的采购需求，公司在该市场仍保持了良好的增长趋势。在智能家具家电、商业设备、教育电子等市场，公司积极布局，不断发展新客户，推动公司芯片在物联网市场的应用。

在智能视频领域，公司以产品突出的性价比优势、面向不同需求的完善的系列产品，以及在低功耗、高智能化处理能力等方面的优势，不断吸引新的客户采用公司的芯片产品。公司在电池类IPC、H.265市场和轻AI市场等领域积极推广，努力配合客户产品的快速落地，知名的智能家居品牌Wyze、中国移动自主智能家居品牌和目、以及乔安、Anker等知名品牌均陆续采用了公司的芯片。此外，贸易战及国际政治经济环境的变化，导致国内安防领域芯片供应商格局发生一定变化，公司积极把握市场机会，加快市场投入和推广力度，凭借公司智能视频芯片在AI处理能力、高清性能、性价比、功耗等方面的市场竞争力，公司的芯片产品得到更多安防类客户的采用，使公司在疫情的影响下在该市场仍保持了良好的增长趋势。

3、经营管理与公司治理

公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，注重人才队伍培养，努力提高公司研发工作效率、提高公司整体管理水平。为进一步促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，充分调动公司管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司于2016年实施了股票期权激励计划，将部分高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员纳入本次激励范围。报告期内，公司股票期权激励计划第三个行权期满足行权条件可以行权，行权期限为2019年4月13日至2020年4月12日。报告期内，公司股票期权激励计划实际行权数量为52,752股，公司完成了本次股票期权激励计划。

4、重大资产重组事项

公司于2019年12月31日收到中国证监会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938号），核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司通过发行股份及支付现金的方式向北京屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原等13名交易对方购买其持有的北京矽成59.99%股权和上海承裕100%财产份额，合计交易作价72亿元，同时拟向包括北京四海君芯有限公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金15亿元。

公司分别于2020年4月和2020年5月完成了北京矽成59.99%股权和上海承裕100%财产份额过户至公司及合肥君正的工商变更登记手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年5月13日受理了公司递交的本次购买资产对应新增股份

发行登记申请，新增股份于2020年5月22日上市。

报告期内，公司积极推进本次重组非公开发行股份募集配套资金事项的相关工作，公司将在核准文件有效期内完成本次非公开发行并及时进行披露。

5、合肥君正研发楼建设

由于新冠疫情的影响，合肥君正二期研发楼相关工作有所延迟，报告期内，公司完成了开工建设前的市政审批工作，确定了施工、监理等相关合作单位，并于报告期末开工建设。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2020年4月和2020年5月完成了北京矽成59.99%股权和上海承裕100%财产份额过户至公司及全资子公司合肥君正的工商变更登记手续。公司于2020年5月完成对北京矽成的资产交割，北京矽成财务报表自2020年6月起纳入公司合并报表范围。

北京君正集成电路股份有限公司

法定代表人：刘强 _____

二〇二〇年八月二十六日